



产品简介

- KXS801-03R是一款双组分加成型有机硅灌封胶。该产品具有较好的流动性，可在-60℃~+220℃范围内长期使用；能够对电子元器件及模组起到良好的密封、绝缘保护及抗冲击性能。

产品特点

- 韧性好
- 耐高低温，可耐受-60~220℃
- 可室温或加温固化
- 优异的绝缘性

典型性能

检测项目		参考标准	单位	数值	
固化前性能	外观	目测	/	A组分	白色流体
				B组分	白色流体
	粘度	ASTM D2196	cps	A组分	4,000-8,000
				B组分	4,000-8,000
	密度	ASTM D792	g/cm³	A组分	1.15±0.05
				B组分	1.15±0.05
混合后性能	配比（重量比或体积比）		/	1:1	
	混合后粘度	ASTM D2196	cps	4,000-8,000	
	可操作时间	ASTM D2196	min	40-90	
	初固时间	ASTM D2240	h	6-8	
	固化时间	ASTM D2240	h	@25℃	24
			min	@80℃	30-40
固化后性能	外观	/	/	白色固体	
	硬度	ASTM D2240	Shore-A	≥35	
	密度	ASTM D792	g/cm³	1.15±0.05	
	拉伸强度	GBT 528-2009	Mpa	3.5	
	伸长率	GBT 528-2009	%	170	
	介电强度	ASTM D149	kV/mm	≥15	
	体积电阻率	ASTM D257	Ω.cm	>1*10 ¹³	



**使用方法：**

- **混合前：**先将A、B组份分别搅拌均匀。
- **混合：**按重量比A：B=1:1，准确称量两组份放入干净的容器内搅拌均匀。
- **脱泡：**可自然脱泡和真空脱泡，自然脱泡：将混合均匀的胶静置10-15分钟，真空脱泡：真空度为0.08-0.1MPa，抽真空5-10分钟。
- **灌注：**应在操作时间内将胶料灌注完毕，否则影响流平。灌封前基材表面保持清洁和干燥。
- **固化：**室温或加热固化均可。温度升高，固化速度变快。气温低时，建议采用加热方式固化。

注意事项：

- 远离儿童存放。
 - 胶料密封贮存。混合好的胶料一次用完，避免造成浪费。
 - 本品属非危险品，但勿入口和眼。
 - 胶液接触一定量的以下化学物质会不固化：
 - N、P、S有机化合物。
 - Sn、Pb、Hg、As等元素的离子性化合物。
 - 含炔烃及多乙烯基化合物。
- ✓ 为了避免上述现象，所以在线路板上使用时尽量擦干净上面残留的松香，尽量使用低铅含量的焊锡。

包装规格、储存与运输：

- **包装规格：**
 - 1kg/套（A组份：500g/罐；B组份：500g/罐）；
 - 50kg/套（A组份：25kg/桶；B组份：25kg/桶）；
 - 其他规格可以根据客户需求进行订制；
- **储存：**最佳储存温度：≤30℃，有效期：6个月。
- **运输：**此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

联系我们：张艳：138-5168-3378；
荣岩：180-6607-5325；田晓冰：152-5095-2541；
许飞艳：132-7663-5250；杨慧子：159-9624-3638

